



LOTPASTE SP2200D

Bleifreie No-Clean Lotpaste RELO

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Stannol SP2200D Lotpaste ist für den Einsatz mit der Legierung TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) und anderen entwickelt worden. Sie enthält ein hochaktives Typ L No-Clean Flussmittel. Mit einer speziellen Formel für ausgezeichnete Benetzung erfüllt sie die Anforderungen einer Großserienfertigung, bei der die Bauteile und Leiterplatten oftmals eine nicht optimale Lötbarkeit aufweisen. Die Benetzungseigenschaften wurden für alle bekannten bleifreien Leiterplatten- und Bauteilbeschichtungen optimiert. Die geringen Mengen an Rückständen nach dem Reflow sind elektrisch sicher und müssen nicht entfernt werden.

PRODUKTMERKMALE

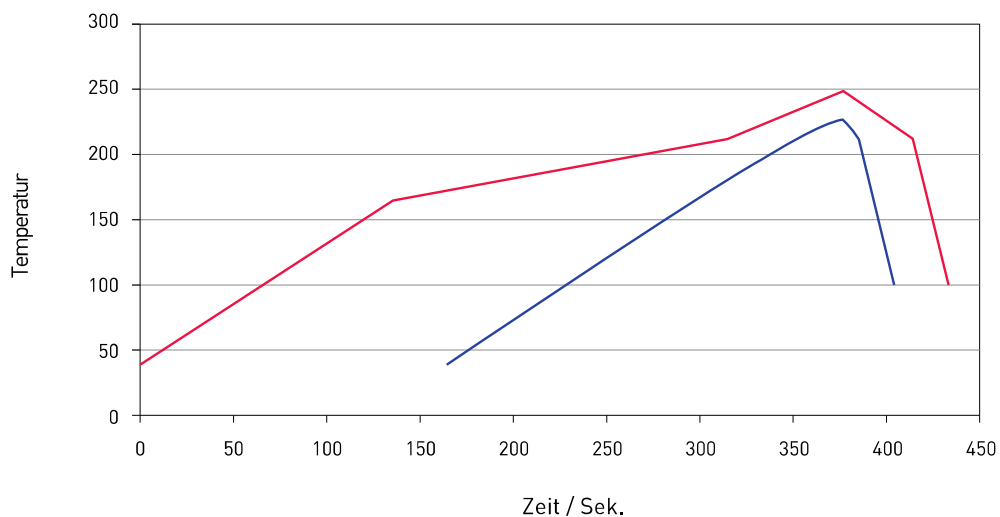
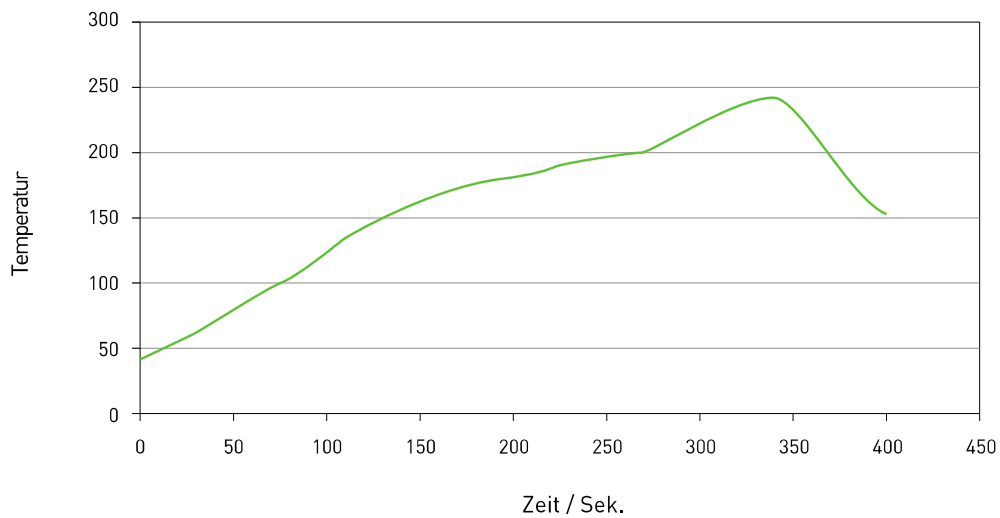
Das Produkt bietet folgende Vorteile:

- **Speziell zum Einsatz mit bleifreien Legierungen entwickelt**
- **Reflow unter Luft oder Stickstoff möglich**
- **Sehr gute Benetzung auf den meisten Oberflächen, auch Ni und Pd**
- **Verarbeitungstemperatur 20-32°C**
- **Hohe Nassklebekraft für Einsatz auf High-Speed Bestückautomaten**
- **Gute Dispens-Eigenschaften**

ANWENDUNG

Pastendosierung: Die Lotpaste SP2200D wurde für die Anwendung mit verschiedenen Dosiereinrichtungen entwickelt. Von Zeit- / Druckdosierern über Quetschventildosierer bis hin zu Jetdosiergeräten. Mit der Legierung TSC305 in der Partikelgröße Typ 3 (25-45 µm) kann sie auf die meisten verfügbaren Dosiersysteme angewendet werden. Die Lotpaste SP2200D hat eine Offenzeit (Standzeit auf der Leiterplatte) von mindestens 8 Stunden. Während dieser Zeit bleibt die Viskosität für eine ausreichende Klebrigkeit der Komponenten erhalten. Die genaue Zeit für eine ausreichende Klebekraft hängt immer von den Umgebungsbedingungen in der jeweiligen Produktionsumgebung ab. Wenn die Zeit zwischen Pastenauftrag und Reflow 6 Stunden überschreitet, wird empfohlen, die Baugruppe in einem geschlossenen Behälter zu lagern, um ein Austrocknen der Paste zu verhindern. Dies ist insbesondere bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von > 83% der Fall.

Reflowprofile: Der Reflowprozess kann unter Luft und unter Stickstoff erfolgen. Folgend ist ein Temperaturprofil aufgeführt, das bei der Verwendung mit der Lotpaste SP2200D gute Benetzungsergebnisse gezeigt hat. Es können aber auch, je nach vorhandener Anlagentechnik und Lötgut, andere Profile verwendet werden. Für diese Lotpaste wird ein lineares Reflowprofil empfohlen, bei Verwendung eines Sattelprofiles sollte die Temperaturbelastung in der Vorheizung bei Temperaturen um 180°C eine Zeit von 120sec nicht überschreiten.



EMPFEHLUNGEN PROZESSFENSTER	MAX (ROT)	MIN (BLAU)
Peaktemperatur:	250°C	230°C
T>217°C:	100sec.	30sec.
100°C bis 217°C:	260sec.	130sec.

Reinigung: Die Stannol SP2200D wurde als No-Clean Lotpaste entwickelt. Das bedeutet, dass eine Reinigung der Rückstände nicht erforderlich ist. Ist eine sehr hohe elektrische Sicherheit zu gewährleisten, können Oberflächenisolationswiderstandsmessung und Messungen der ionischen Kontamination helfen, eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Reinigung zu treffen. Sollte eine Reinigung notwendig sein, können die Rückstände in herkömmlichen Reinigungsprozessen entfernt werden. Empfehlungen zu möglichen Reinigungsmitteln erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Lotpulver: Die erlaubten Verunreinigungen in diesem Lotpulver entsprechen der ANSI/J-STD-006 und DIN EN 29453. Die nominelle Lotpulverpartikelgröße beträgt 25-45µm (Typ 3) mit einer exakt kontrollierten Korngrößenverteilung und Kugelform.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SP2200D TSC305-87-3
Legierung:	Sn96,5Ag3,0Cu0,5 (Ecoloy TSC305)
Schmelzbereich, °C:	217-223
Metallgehalt, %:	87
Lotpulver, µm:	25-45 (Typ 3)
Applikation:	Automatisches und manuelles Dispensen

Tests	Spezifikation	Ergebnis
Kupferkorrosion:	ANSI/J-STD-004B	bestanden
Kupferspiegelkorrosion:	ANSI/J-STD-004B	bestanden
Oberflächenisulationswiderstand:	ANSI/J-STD-004B - IPC-TM650	bestanden
	JIS-Z-3284 85°C/85%rF	bestanden
	JIS-Z-3284 40°C/90%rF	bestanden
	DIN IEC 61189	bestanden
Silberchromatpapiertest:	ANSI/J-STD 004 / QQS-571	bestanden
Chloridanteil:	IPC-TM-650	<20ppm
Bromidanteil:	IPC-TM-650	<20ppm
Lotkugeltest:	nach 1h bei RT	bestanden, Klasse 1
	nach 24 bei RT	bestanden, Klasse 1
Nassklebekraft:	JIS-Z-3284	mindestens 100g nach 24h
Klasse der Flussmittelaktivität:	DIN 29454-1	1.2.2.C
	J-STD-004B	RE LO

LIEFERFORMEN

Stannol SP2200D Lotpaste kann in den folgenden Gebinden geliefert werden:

10cc Kartusche = 40g

30cc Kartusche = 110g

Auf Anfrage stehen auch andere Verpackungsarten zur Verfügung. Diese können mit bestimmten Mindest- abnahmemengen verbunden sein.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bei einer Lagertemperatur von 2-8°C beträgt die Mindesthaltbarkeit (ab Herstellungsdatum) 4 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Lotpaste in Kartuschen (55cc oder 10 cc) sollten aufrecht stehend mit der Verschlusskappe der Dosieröffnung nach unten gelagert werden. Ist dies nicht möglich, empfehlen wir die liegend gelagerten Kartuschen 1x pro Woche um 180° zu drehen, um eine Separation zu vermeiden. Lassen Sie die Lotpaste vor Verarbeitung ca. 2-6h langsam im geschlossenen Originalgebinde auf Raumtemperatur erwärmen.

Geöffnete Kartuschen: Empfehlung maximal 16h bei Raumtemperatur

Hinweis: Angebrochene Kartuschen innerhalb von 7 Tagen – bei entsprechender Kühlung – aufbrauchen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und Sicherheitsmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.